

無電解めっき方法、並びに、配線装置およびその製造方法

無電解めっき方法による銅の選択的堆積ができる配線装置の製造方法。

基板上に白金とパラジウムとの合金からなる触媒核をスパッタ法により付着させ、その表面に絶縁膜を形成する。フォトリソグラフィ法により、絶縁膜の一部を除去して溝を形成し、触媒核を露出させる。無電解めっきにより、この溝に配線となる金属（銅）膜を形成する。

銅を堆積する各種の方法の内、めっき法は高温も高真空も不要であり、かつ、無電解めっき法では電極も不要である。

配線装置に係る発明の実施形態の一例を示す斜視図



本実施の形態の例

概要と特徴

用途

実用化・情報

集積回路の配線装置の製造。

集積回路の配線材料として従来のAlに代わり、銅が注目されている。本発明は、無電解めっき法による実用的な製造方法の具体的提案であり低コストかつプロセス容易という利点がある。

[試作・実験] 完了

[製造・販売実績] 無

[技術情報の提供] 公開特許公報 技術資料

[連絡先] (財)理工学振興会

〒226-8503

横浜市緑区長津田4256東京工業大学内

TEL.045-921-4391 FAX.045-921-4395

技術移転

特許等

(1) 形態 特許実施権供与

(2) 相手先 企業規模不問

(3) 地域 国内・海外いずれでもよい

出願人：(財)理工学振興会

発明者：杉浦修、西川恵一郎

出願日：2000年5月30日

出願番号：特願2000-161666

公開日：2001年12月7日

公開番号：特開2001-335952